本ドキュメントはCypress (サイプレス) 製品に関する情報が記載されております。本ドキュメントには、仕様の開発元企業として「スパンション」，「Spansion」，「富士通」または「Fujitsu」の名が記載されておりますが、これらの製品は Cypress が新規および既存のお客様に引き続き提供してまいります。

商品仕様の継続性について
Cypress 製品として提供することに伴う商品仕様としての変更はなく、ドキュメントとしての変更もありません。また本ページのお知らせは、変更情報として追記いたしません。本ドキュメントに変更情報が記載されている場合、それは本お知らせを除いた前版からの変更点です。なお、今後改訂は必要に応じて行われますが、その際の変更内容は改訂後のドキュメントに記載いたします。

オーダ型格および品名について
Cypress は既存のオーダ型格および品名を引き続きサポートいたします。これらの製品をご注文の際は、このドキュメントに記載されているオーダ型格および品名をご使用ください。

詳しいお問い合わせ先
Cypress 製品およびそのソリューションの詳細につきましては、お近くの営業所へお問い合わせください。

サイプレスについて
サイプレス (銘柄コード：CY) は、車載や産業機器、ネットワーキング プラットフォームから高機能民生機器およびモバイル機器まで、今日の最先端組み込みシステム向けに高性能で高品質のソリューションを提供します。NOR フラッシュ メモリや F-RAM™、SRAM、Traveo™ マイクロコントローラー、業界唯一の PSoC®プログラマブル システムオンチップ ソリューション、アナログおよび PMIC Power Management IC、CapSense®静電容量タッチセンシング コントローラー、Wireless BLE Bluetooth® Low-Energy、USB コネクティビティ ソリューションなど、幅広い差別化製品ポートフォリオを、一貫した革新性と業界最高クラスの技術サポート、比類のないシステム バリューとともにグローバルに提供します。

富士通半導体デバイス
SUPPORT SYSTEM

SS01-71002-1

DSU-FR20/30エミュレータ

MB2197-120用QFP208Pヘッダ

MB2197-127

取扱説明書

FUJITSU

はじめに

このたびは，DSU－FR*20／30エミュレータ用のMB2197-120用QFP208Pヘッダ[MB2197－127]をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品は，FR－DSU3用PGA401Pエバボード(MB2197－120)とあわせて使用し，DSU－FR20／30シリーズ用エミュレータ(MB2197－10)とMB91F361等のQFP208Pパッケージ(パッケージコード：FPT-208P-M01)のFRシリーズのMCUを使用したユーザシステムとの接続に使用します。本製品適合MCU，適合評価用MCUについては弊社営業担当にご確認ください。

本説明書は，DSU－FR20／30エミュレータ用のMB2197-120用QFP208Pヘッダ[MB2197－127]の取扱いについて説明したものです。ご使用いただく前に必ずお読みください。

*：FRは，FUJITSU RISC CONTROLLERの略で富士通(株)の製品です。

⚠注意

注 意	本製品の取扱い方法および使用環境は，MB2197－01に準じます。 本製品は，尖った部分がやむなく露出しております。取扱いには十分ご注意ください。

1. 本資料の記載内容は，予告なしに変更することがありますので，ご用命の際は当社営業担当部門にご確認ください。
2. 本資料に記載された情報・回路図は，半導体デバイスの応用例として使用されており，実際に使用する機器への搭載を目的としたものではありません。また，これらの情報・回路図の使用に起因する第三者の特許権，その他の権利侵害について，当社はその責任を負いません。
3. 本資料に記載された内容を，当社に無断で転載または複製することはご遠慮ください。
4. 当社半導体デバイスは，標準用途（コンピュータ／ＯＡなどの事務用機器，産業／通信／計測用の関連機器，パーソナル／家庭用の機器など）に使用されることを意図しています。その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり，人体に危害が及ぶ恐れのある，または極めて高い信頼性が要求される特別用途（航空・宇宙用，原子力制御用，海底中継器，走行制御用，生命維持のための医療用など）にご使用をお考えのお客様は必ず事前に当社営業担当部門までご相談ください。ご相談なく使用されたことにより発生した損害などについては，責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 半導体デバイスはある確率で故障が発生します。当社半導体デバイスが故障しても，結果的に人身事故，火災事故，社会的な損害を生じさせないよう，お客様は，装置の冗長設計，延焼対策設計，過電流防止対策設計，誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。
6. 本資料に記載された製品が，「外国為替および外国貿易法」に基づき規制されている貨物または技術に該当する場合には，本製品を輸出するに際して，同法に基づく許可が必要となります。

©1999 FUJITSU LIMITED Printed in Japan

1．製品および添付品の確認

DSU－FR20／30エミュレータ用QFP208Pヘッダ[MB2197－127]をご使用になる前に，以下の部品が揃っていることを確認してください。

- ヘッダボード： 1台
- QFP208PICソケット[NQPACK208SD 東京エレテック(株)]： 1個
- QFP208PICソケット蓋(ネジ付き)[HQPACK208SD 東京エレテック(株)]： 1個
- ヘッダボード固定用ネジ： 4本
- 取扱説明書（和文）（本書）： 1部
- 取扱説明書（英文）： 1部

2．取扱い上の注意

DSU－FR20／30エミュレータ用QFP208Pヘッダ[MB2197－127](以下，ヘッダボードと称します)は，確実な接触を保つため「構造上の工夫」ならびに「寸法精度の向上」を図り，精巧に作られている関係上，比較的強度が低くなっております。したがって，常に正しく，良い環境でお使いいただくために，「ヘッダボードの接続」に際しては，次のことにご注意ください。

- ヘッダボードとユーザボードを接続するために，MCU用ICソケットとしてヘッダボード付属のLQFP208PICソケットを必ずユーザボードに実装してください。ヘッダボードとユーザボードの接続を図1に示します。

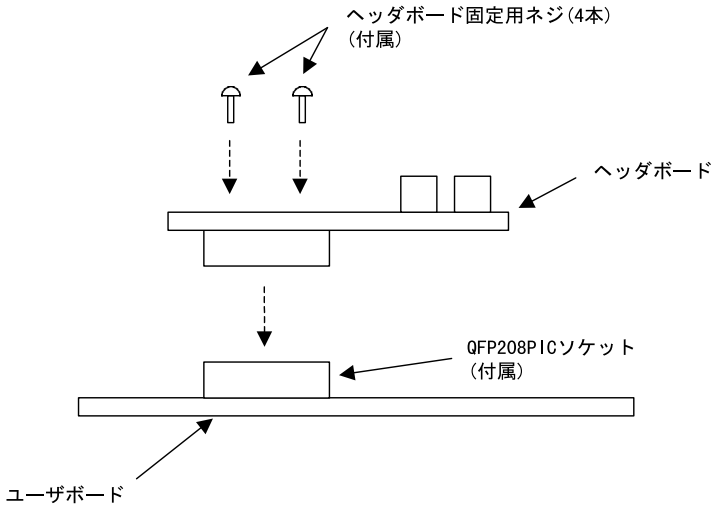


図1　ヘッダボードとユーザボードの接続

- ヘッダボードとQFP208Pヘッダの勘合部は非常にデリケートです。挿抜は必ず垂直方向に行ってください。また，接続した状態でヘッダボードに無理な力がかからないように注意してください。

- 量産MCUをQFP208PICソケット上に接続する際は，付属のQFP208PICソケット蓋を使用し，ICソケット蓋付属のネジで固定します。量産MCUの取り付けは以下の通りに行います。図2に量産MCUの固定方法を示します。

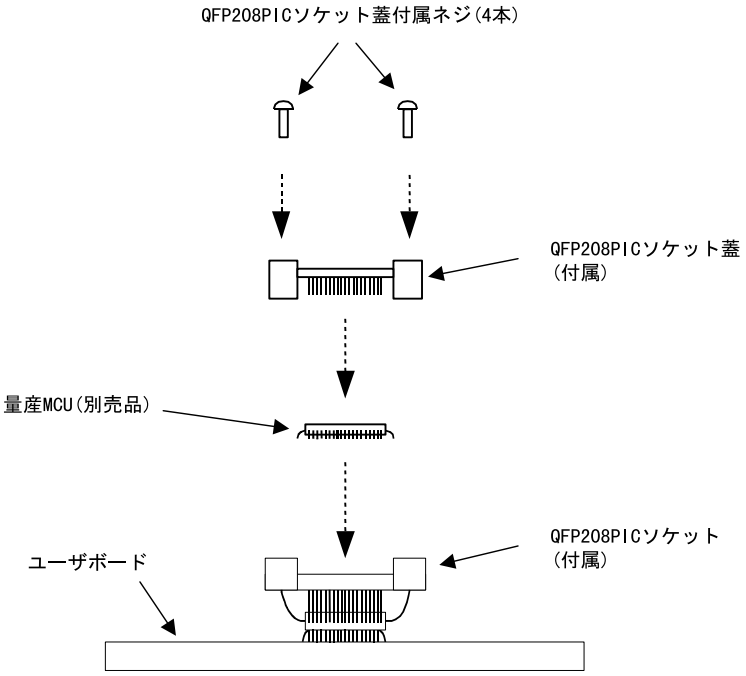


図2　量産MCUの接続

SS01-71002-1

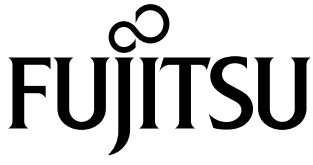
富士通半導体デバイス・SUPPORT SYSTEM

DSU-FR20/30エミュレータ
MB2197-120用QFP208Pヘッダ
MB2197-127
取扱説明書

1999年8月　初版発行

発　行　**富士通株式会社**　電子デバイス事業推進本部

編　集　技術標準部　ドキュメント技術部


FUJITSU